

Pressemitteilung

#ew24: Halle 3, Stand 255

POLYRACK TECH-GROUP realisiert selbst komplexe Anforderungen an Gehäuse- und Systemlösungen

Straubenhardt, 21. Februar 2024 – Vom 9. bis 11. April 2024 stellt die POLYRACK TECH-GROUP in Halle 3, Stand 255 diverse Praxisbeispiele für Gehäuse- und Systemlösungen vor. Die Produktapplikationen zeigen den Besuchern der embedded world 2024, wie Unternehmen von der Beratungs- und Umsetzungskompetenz POLYRACKs als Partner und Experte für komplexe Verfahren und State of the Art-Technologien profitieren.

Zum umfangreichen Dienstleistungsportfolio gehören zum Beispiel:

- Entwicklungsbegleitende Vorbereitung für CE- und UL-Zulassung für elektromechanische Baugruppen und Systemlösungen
- Verarbeitung aller thermoplastisch formbaren Kunststoffe (0,5 - 6.000 Gramm), mit und ohne Füllstoffe/Verstärkung, wie
 - Standardkunststoffe (z.B. PP, PMMA, ABS, PS)
 - Technische Kunststoffe (z.B. PC, PA, POM, PBT)
 - Hochleistungskunststoffen (z.B. PVDF, PPS, PEEK, LCP)
- Vorgelagerte Entwicklung, wie z.B. die simulationsgestützte Bauteilbetrachtung via Füll- und Verzugsanalyse

Vor Ort stehen zudem die folgenden Produktreihen für ein erstes Hands-On zur Verfügung:

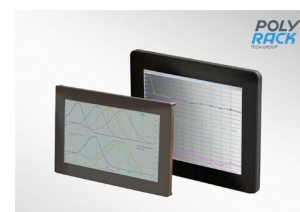
FrameTEC: Das elegante industrielle Tischgehäuse für 19“-Einschübe mit hoher Flexibilität bei Gestaltung und Maßen vereint ästhetische Formgebung und Konstruktion in einem ehrlichen, sich selbsterklärenden Design. Die große Anzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und wechselbaren

POLY
RACK



if
FrameTEC

POLY
RACK



PanelPC 2

POLY
RACK



EmbedTEC SFF

Komponenten macht das Gehäuse zum idealen Träger in Anwendungsbereichen mit hohem Qualitätsanspruch.

PanelPC 2: Die Gehäuseserie wurde speziell für Panel PC- und/oder Anzeige- und Bediensysteme im industriellen Umfeld entwickelt (-20°C bis +70°C). Der Displayrahmen aus massivem Aluminium kann für Bildschirmdiagonalen von 10,1" bis 21,5" und verschiedene Covergläser angepasst werden. Das Gehäusedesign ist primär für die Verwendung von PCAP-Touches ausgelegt.

EmbedTEC SFF: Das optisch ansprechende Aluminium-Tischgehäuse ist die elegante Verpackung für embedded-Boards der Formfaktoren – embedded NUC (eNuc) – pico-ITX (pITX, 2,5") – SMARC – QSeven – SBC's (z.B. "Raspberry Pi"*). Neben der Verwendung als Tischgehäuse kann dieses Gehäuse auch per Adapter oder VESA Halterung an die Wand, sowie in vielfältiger Orientierung an die Hutschiene montiert werden.

###

Über die POLYRACK TECH-GROUP (www.polyrack.com)

Die POLYRACK TECH-GROUP entwickelt und produziert hochqualitative Systemlösungen für die Elektronik. Dank breitem Technologiespektrum in der mechanischen Fertigung, Systemtechnik/ Elektronik, Kunststofftechnik und Oberflächenbearbeitung bietet POLYRACK Electronic Packaging für jeden Bedarf. Das Leistungsangebot reicht von der Beratung in der Konzeptionsphase über die Entwicklung, Produktion und Assemblierung bis hin zu Logistiklösungen und Sourcing Services.

Die Unternehmensgruppe umfasst die POLYRACK Electronic-Aufbausysteme GmbH, RAPP Kunststofftechnik GmbH, POLYRACK Aerospace GmbH, Metalle in Form Geräteteile GmbH sowie Tochterunternehmen in Amerika, Belgien, China und der Schweiz. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt weltweit über 500 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen summierten Umsatz von 94,2 Millionen Euro in der Gruppe.

Pressekontakt:

POLYRACK TECH-GROUP, Maximilian Schober,
Tel: +49 7082 7919-771, maximilian.schober@polyrack.com

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations, www.lorenzoni.de
Melanie Nagy, Tel: +49 8122 55917-16, melanie@lorenzoni.de